

[11]公告編號：448454

[44]中華民國 90年(2001) 08月01日

發明

全 3 頁

[51] Int.Cl<sup>06</sup>: H01H1/64

[54]名稱：導電片材之銀接點固定方法

[21]申請案號：089100581

[22]申請日期：中華民國 89年(2000) 01月15日

[72]發明人：

林大山

施純銘

台北市111士林區中山北路六段419巷1號5樓

台北市中山北路六段二五二巷五號五樓

[71]申請人：

勝大彈簧股份有限公司

台北縣三重市三和路四段八十三號

[74]代理人：李文禎 先生

1

2

[57]申請專利範圍：

一種導電片材之銀接點固定方法，其方法步驟依序為：

沖胚—係令導電片置於第一下模上，並藉由第一上模相對導電片沖壓，使導電片順應第一上模之形狀而形成一固位孔，其成型並令導電片多餘之材料受擠壓而於固位孔外形成一嵌合垣；

攻牙—係於導電片之固位孔內部攻牙形成螺孔；

植固銀線—係以裁切成適當長度之銀線內置於固位孔中，利用第二上模將銀線壓實填充於固位孔，使固位孔內之螺牙得嵌緊銀線，令銀線無法脫離固位孔；

修整銀點—係利用第三上模將銀線頂部修整成一抵頂垣而平貼於導電片上，且藉由第二下模將外露於固位孔外之嵌合垣相對固位孔向內推抵，使嵌合

垣受第二下模推頂而伸進固位孔內，迫使孔內之銀線受推擠而更密實固結於固位孔之螺牙者。

圖式簡單說明：

5. 第一圖係本發明之製作流程圖

第二圖係本發明第一步驟之製作形態示意圖

第三圖係本發明第二步驟之製作形態示意圖

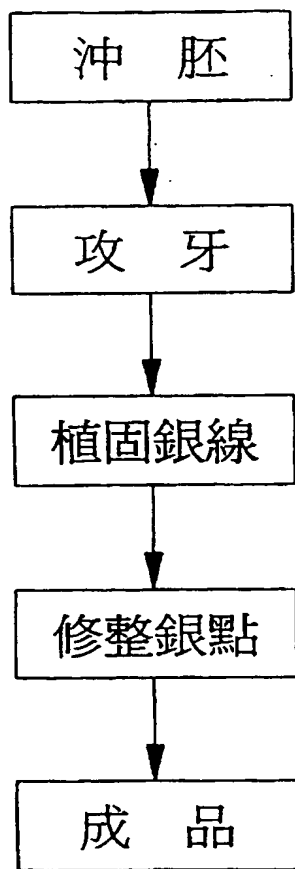
10. 第四圖係本發明第三步驟之製作形態示意圖

第五圖係本發明第四步驟之製作形態示意圖

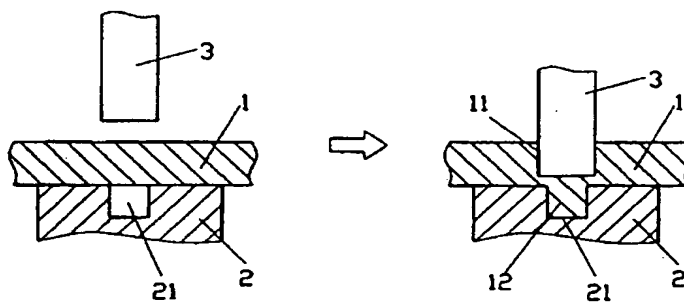
15. 第六圖係本發明製作成品形態之結構示意圖

第七圖係習用品之結構示意圖

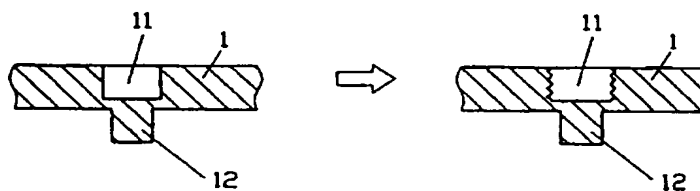
第八圖係另一習用品之結構示意圖



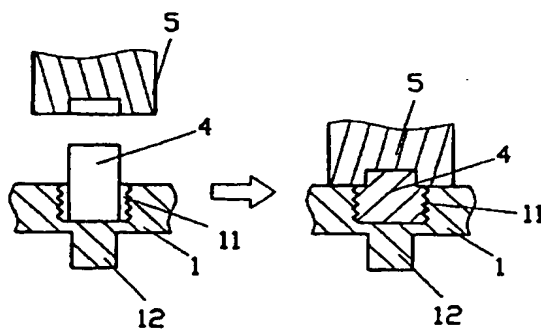
第一圖



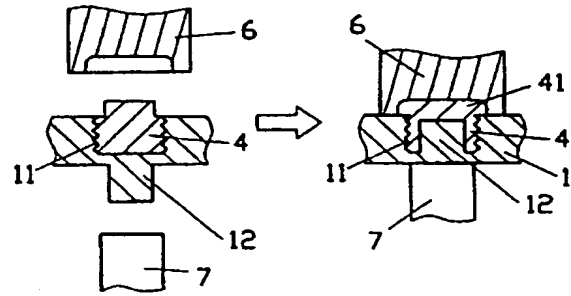
第二圖



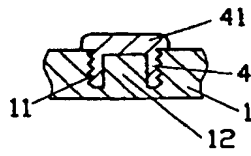
第三圖



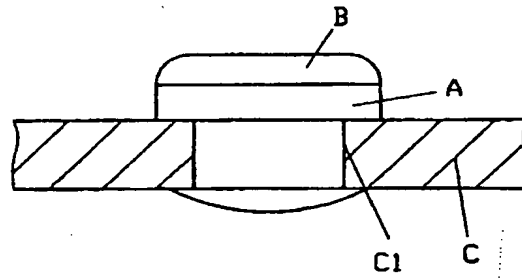
第四圖



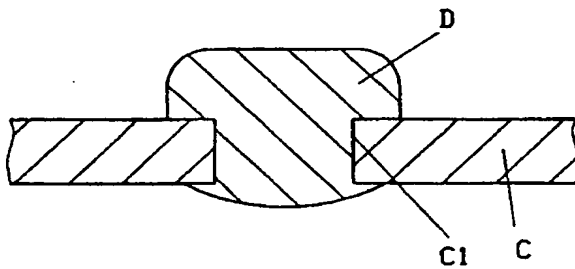
第五圖



第六圖



第七圖



第八圖